1. 自我介绍

尊敬的面试官您好，我是丁志文，目前就读于杭州电子科技大学，所学的专业是电子科学与技术，在校期间负责导师的一个项目，主要工作是研究石墨烯薄膜和铜膜复合材料的制备工艺，利用高功率脉冲电流源对复合材料进行载流性能测试，通过红外仪、OM、SEM、XRD、XPS、Raman等对氮掺杂石墨烯铜膜复合材料进行表征以及失效机理分析，红外仪用于分析材料在载流测试过程中的温度变化，扫描电子显微镜用于表征材料在测试完成后的微观结构，观察复合材料是否会由于载流测试过程中的电迁移或者热效应而导致出现其他的一些物理结构变化。并且结合comsol仿真软件验证其载流能力提升机制。以及每次项目汇报的ppt制作，具有较强的数据分析处理能力，目前以第一作者发表二区SCI论文一篇。我通过了大学英语六级，听说读写都是ok的。

使用Verilog语言完成基于RISC-V架构的CPU开发，实现五级流水线架构。取指：首先要从指令存储器中取出指令，译码：分析指令，控制单元产生控制信号，执行：ALU控制单元执行算术运算，访存：ALU运算结果被送往数据内存的地址端口，写回：所有与内存相关的数据必须在寄存器中进行操作，将load指令从内存读出的数据或ALU运算结果写回寄存器。

活泼开朗，善于沟通。

以上就是我的自我介绍，谢谢。

**主修课程：数字电路、模拟电子技术、数学物理方法、高等数学、线性代数、概率统计、基础物理、电子电路设计与制作**

**半导体器件物理、固体电子器件基础、电子材料制备与表征分析实践、纳米材料**

职业规划

我的计划是一直在研发岗这个岗位发展，个人对研发这一块也是比较感兴趣的，所以如果能加入贵公司我把这看作一个学习技能和行业知识的机会。另外我希望通过不断提升自己的专业技能，也能够参与到企业的发展当中去。从长远来看，通过自己的专业通道以及每年的升职加薪机会快速达到企业的中上层。

入职后是否有一对一导师制培训

这个岗位在贵公司的发展前景是怎样的，晋升路径是怎样的

Thank you so much for giving me this opportunity to have this job interview. I would like to introduce myself to you briefly. My name is Zhiwen Ding. I’m 24 years old, and I come from Jiangxi Province. I’m currently studying for my master’s degree at Hangzhou Dianzi University of electronic science and technology. My major is electronic science and technology, and I will graduate in July next year. Although my major is not related to teaching, it doesn't matter. Since I was a child, I was always at the top of my class in math. When I was in high school, my dream was to become a math teacher. I had learned several lessons related to math during my university, such as advanced mathematics, probability theory, methods in mathematical physics, and so on. In addition, I had a two-month experience as a math teacher during a summer holiday. As a result, I have a good command of how to teach and manage students. I believe that I will get along well with students, and I will be patient with them. I’m quite interested in math teacher, so I applied for this job. I sincerely hope to get the chance to work for your company. Thank you for your attention.

1. 项目

设计SoC系统AHB-Lite总线：1x Master，2x Slaves；设计AHB到APB的转接bridge。设计SoC系统APB总线：可支持7 APB外设；